



平成 29 年 12 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
(コード：3445、東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行  
(TEL. 03-5709-7685)

## 北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司との合弁会社設立による 有研半導体材料有限公司の連結子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 1 日付で、北京有色金属研究総院（以下、「GRINM」と記載。）及び福建倉元投資有限公司（以下、「福建倉元」と記載。）と三社間で合弁契約（以下、「本件契約」と記載。）を締結し、北京有研 RS 半導体材料有限公司（以下、「BGRS」と記載。）を設立すると共に、GRINM の 100%子会社である有研半導体材料有限公司（以下、「GRITEK」と記載。）を連結子会社化（以下、「本件」と記載。）することについて、取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 本件の目的

当社は、東証一部上場企業であるラサ工業株式会社が、1984 年 1 月より約 25 年間、世界の半導体デバイスメーカーにサービスを提供してきたシリコンウェーハ再生事業を承継して、2010 年 12 月に発足いたしました。その後、半導体生産設備の買取・販売事業やソーラー事業への参入等、事業の多角化を推進する一方、台湾工場新設・三本木工場増設により、主要事業であるシリコンウェーハ再生事業の拡大にも努めてまいりました。

2015 年 3 月東京証券取引所に上場以来、決算説明資料等で開示のとおり、当社は、中・長期的な経営方針の 1 つとして「中国半導体マーケットへの参入」を掲げております。中国は、半導体製品の内製化を目標として、国内半導体関連企業の育成の為に、2020 年までに国家主導で半導体産業に 5 兆円の投資（海外半導体関連メーカーへの M&A 投資を含む。）を計画しており、当社は、中国で期待される巨大マーケットに参入すべく、設立以来、中国半導体関連企業との関係を構築・強化してまいりました。

関係構築・強化の一環で 2015 年 10 月 19 日付で発表しているとおり、当社は中国の半導体関連企業が加盟している「集成电路材料産業革新戦略連盟」<sup>1</sup>に中国資本企業以外で初めて加盟企業となり、中国国有企業等と関係を密にしながら取引拡大を図っております。

この度、2012 年から技術支援や連盟活動での交流等を通じて良好な関係を構築していた GRITEK に対する資本参加について、GRITEK の親会社である GRINM と本件契約締結に至りました。

本件契約を締結することになった当事会社の 1 社である GRINM は、1952 年に創立された、中国の非鉄金属産業の分野で最も大きな研究開発機関（2000 年に国有企業化）です。傘下に非鉄金属分野に関連する多数の企業を抱える中国有数の企業集団であり、その 100%子会社である GRITEK は、GRINM の第 1 号事業会社であり、シリコンインゴットやプライムウェーハの製造販売を主な事業としております。当社が、GRINM 等と合弁で設立する BGRS を通じて GRITEK を子会社化することで、以下のメリットを得ることができると考えております。

- ① 中国市場におけるプライムウェーハ製造等、非鉄金属分野で有数の企業集団である GRINM が有する信用力・知名度を生かし、プライムウェーハ製造販売事業への参入と中国再生市場におけるシェア拡大が可能になる。

- ② 中国国有企業である GRINM（中央直属企業<sup>164</sup> 番目）が筆頭株主となることで、BGRS も中国が国家主導で実施していく半導体産業への積極投資の恩恵を受けることができる。
- ③ 当社及び GRITEK が加盟している集積回路材料産業革新戦略連盟のネットワークを通じて、半導体生産設備・材料等の取引拡大が見込まれる。
- ④ 当社のグローバルネットワーク網を介し、世界の顧客へアプローチすることで、プライムウェーハ製造販売事業の拡大が期待できる。

当社は、本件を契機として、2025 年まで視野に入れた中国政府が主導する「中国製造 2025」で示された半導体ビジネス機会を大々的に取り込み、プライムウェーハ中国国内立地化に際し、中国政府との関係が深い GRINM と組むことで、中国でのプライムウェーハ製造販売事業を推進してまいります。

また、当社としてはビジネスリスクを最小限にとどめながら、拡大する中国市場において、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

## 2. 合弁会社の概要等

### ① 本件契約の概要

当社、GRINM、福建倉元の三社間で、当社は約 62 百万 US ドルの現金、福建倉元は約 8 百万 US ドルの現金、GRINM は GRITEK の持分 100% を現物出資する形式で、持分比率はそれぞれ、当社 45%、福建倉元 6%、GRINM 49% とする合弁会社を設立いたします。当社と福建倉元の全ての出資金額は、設備投資の原資となります。当社の出資金は銀行借入を予定しており、段階的に出資する予定であります。

### ② 合弁会社 (BGRS) の概要 (予定)

(1) 名 称	北京有研 RS 半導体材料有限公司
(2) 所 在 地	北京市順義区林河工業開発区
(3) 代表者の役職・氏名	方 永義 (董事長、当社代表取締役社長兼務)
(4) 事 業 内 容	半導体硅材料の開発及び販売。半導体関連設備及び材料の開発及び販売。技術移転、技術相談、技術サービス、輸出入業務
(5) 登 録 資 本	138 百万 US ドル
(6) 設 立 年 月 日	2018 年 1 月以降
(7) 決 算 期	12 月
(8) 持 分 比 率	当社 : 45%、GRINM : 49%、福建倉元 : 6%

### ③ 福建倉元の概要

(1) 名 称	福建倉元投資有限公司	
(2) 所 在 地	福建省福州市	
(3) 代表者の役職・氏名	謝 秀琴	
(4) 事 業 内 容	投資事業	
(5) 資 本 金	50 百万人民元	
(6) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	資本関係はございません。
	人的関係	人的関係はございません。
	取引関係	取引関係はございません。

④ GRINMの概要

(1) 名 称	北京有色金属研究総院		
(2) 所 在 地	北京市西城区新外大街2号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 張 少明		
(4) 事 業 内 容	非鉄金属の研究等		
(5) 資 本 金	1,399 百万人民币		
(6) 設 立 年 月 日	1993年3月20日		
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	資本関係はございません。	
	人的関係	人的関係はございません。	
	取引関係	取引関係はございません。	

⑤ GRITEKの概要 (2017年9月30日時点)

(1) 名 称	有研半导体材料有限公司		
(2) 所 在 地	北京市顺义区林河工業開発区		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 周 旗鋼		
(4) 事 業 内 容	シリコンウェーハ及び CZ インゴット・FZ インゴットの生産、販売、開発、関連技術の開発等		
(5) 資 本 金	851 百万人民币		
(6) 設 立 年 月 日	2001年6月21日		
(7) 大株主及び持株比率	GRINM (100%)		
(8) 月 産 生 産 能 力	5, 6, 8 インチシリコンウェーハ 25 万枚、CZ 及び FZ インゴット 17ton		
(9) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	資本関係はございません。	
	人的関係	人的関係はございません。	
	取引関係	シリコンウェーハの委託加工及びシリコン部材の販売	
(10) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期 第3四半期累計期間
純 資 産	347 百万人民币	318 百万人民币	348 百万人民币
総 資 産	619 百万人民币	564 百万人民币	581 百万人民币
売 上 高	321 百万人民币	329 百万人民币	360 百万人民币
営 業 利 益	▲100 百万人民币	▲45 百万人民币	28 百万人民币
経 常 利 益	▲99 百万人民币	▲44 百万人民币	30 百万人民币
当 期 純 利 益	▲98 百万人民币	▲45 百万人民币	30 百万人民币

⑥ 合併会社 (BGRS) の今後の見通し

GRITEK は、2019年12月期～2022年12月期にかけて、河北省唐山市において、土地約 150,000 m<sup>2</sup>、建物（躯体建築済）約 50,000 m<sup>2</sup>の工場に新規設備投資を実施し、あわせて既存設備を集約し、シリコンウェーハ及びシリコンインゴット等を生産する予定です。集約完了後の8インチシリコンウェーハ生産能力は最大で現在の7倍程度（現在5万枚→35万枚）となります。BGRSの各年度の事業計画数値は、別に開示しております『中国プライムウェーハ事業に関する合併会社設立について』をご参照ください。

#### 4. 日程

(1) 取締役会決議日	平成29年12月1日
(2) 契約締結日	平成29年12月1日
(3) 合弁企業設立日	平成30年1月以降(予定)
(4) 出資払込日	平成30年1月以降(予定)

#### 5. 今後の見通し

本件手続完了は来期を予定しておりますので、今期業績予想への影響はない見込みです。また、中国当局の審査次第ではスケジュールの遅延の可能性がございます。来期の当社グループ連結決算見込みに関しましては、本件影響を踏まえ、判明次第、速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成29年8月3日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成29年12月期)	9,450百万円	2,550百万円	2,650百万円	1,630百万円
前期連結実績 (平成28年12月期)	8,849百万円	1,557百万円	1,450百万円	869百万円

<sup>i</sup>正式名称(中国簡体字)は集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟(略称:ICMtia)。

(参考URL) <http://www.icmtia.com/icmtia/lmcy/lmcy.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0>

<sup>ii</sup>国有企業の中でも国有資産監督管理委員会(国資委)直属で、著名な大手企業など中国経済をリードする企業98社の総称。

(参考URL) <http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html>